

## 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号: 2026-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称</b>	第一创业证券      申万宏源证券      香港众睿天下 和常投资              嘉谏创投              宁波银行 国投证券              国金证券              通赞咨询 瀛赐基金              中金众鑫              西南证券 个人投资者
<b>会议时间</b>	2026年3月24日、25日、26日
<b>会议地点</b>	线下
<b>上市公司接待人员姓名</b>	证券事务代表: 陈玲
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>Q:</b> 公司此前投资的企业, 目前在研发进度及出货量等方面的进展如何?</p> <p><b>A:</b> 公司已与被投资企业协同推进产品研发, 发展符合预期。其中, 蜂窝通信领域的 Cat.1 射频前端芯片产品已开始小批量出货, 并通过模组大厂认证, 2026年将形成收入。Cat.1 是 LTE UE-Category1 的简称, 是由 3GPP 制定的 LTE (4G) 通信标准, 具备中速率、低延时、广覆盖等特点的 Cat.1 技术将成为物联网应</p>

用的新宠。此外，超宽带（UWB）技术能在空鼠、脚踏雷达、跟随定位、车钥门锁、Tag 跟踪、活体存在检测、音频数传等领域被广泛应用，公司已与被投资企业协同推进超宽带产品研发，近期已送样至相关客户。

**Q：公司后续毛利率和净利率的修复路径及拐点何时出现？公司计划如何提升毛利水平？**

**A：**2026 年公司毛利率预计将有所改善，并在 2026 年全年呈现增长态势。公司将通过提升高毛利产品占比来改善整体毛利水平，主要举措包括：持续提升 Wi-Fi 7 等高毛利产品的收入占比；大力拓展低空经济、工业级 IoT（如智能电表、智能水表等）等高毛利应用场景，稳步扩大相关产品出货规模；同时依托海外市场收入占比的提升，进一步优化整体毛利结构。

公司目前已形成比较明确的战略规划与产品布局：1、保持核心业务的领先地位：深耕 Wi-Fi 射频前端，构筑强大的自主知识产权，稳步迈入国际市场；深度绑定博通、高通、联发科等国际主流主芯片平台，认证壁垒高、客户粘性强；受益路由器、网关、智能家居换机周期，短期 Wi-Fi7 代际升级红利明显；同步布局 Wi-Fi8，保持代际领先，持续领跑技术迭代。2、近期落地：持续推动低空经济产品放量；深化智能家居与 Wi-Fi HaLow 等低功耗方案在表计、工控等领域规模化落地；依托全球品牌客户资源，扩大方案渗透与份额提升；加速推进 UWB、蜂窝类射频前端产品、V2X 车联网产品的落地，快速将技术优势转化为产品竞争力；3、加强技术探索与储备：通过投并结合、联合研发等方式，继续布局远距通信产品，配合新兴市场发

展，力争取得新产品的先发优势；4、深化客户合作：巩固与全球优质头部客户的合作关系，积极拓展新兴领域优质客户，持续提升产品渗透率与市场份额。5、优化运营效率：强化供应链协同与成本管控能力，提升高毛利产品占比，实现经营规模与盈利水平同步提升。谢谢！

**Q：公司如何看待车规产品线未来的起量情况？**

**A：**因车规级产品研发、认证及大规模量产的周期较长，车规射频前端芯片未来几年起量确定性强，是射频芯片领域具备想象空间的细分赛道。我们认为核心驱动因素有：1、汽车的电动化、智能化、网联化、共享化，正让汽车从“机械体”转向“智能移动终端”，射频前端芯片成为标配。2、自动驾驶升级，需要多传感器融合及车路协同，射频是感知与通信的核心硬件。3、通信技术持续迭代，5G-A、6G、NTN 卫星通信、Wi-Fi 7/8 等技术协同，持续提升单车射频复杂度与价值量。4、国产替代：中国射频企业加速车规化，相较于海外企业的性价比优势，将推动车规产品的渗透率提升。

**Q：结合目前情况，贵司认为是晶圆端产能更趋紧，还是封测端产能更趋紧？**

**A：**公司已关注到市场端出现产能紧张的情况。随着AI 芯片、硅光芯片、存储芯片等产品需求上涨，抢占了较多晶圆及封测产能，其他行业的晶圆及封测产能进一步被挤压。公司具备稳定、长期的供应链合作，且分别在境内、境外进行了供应链双备份，目前供货情况良好，晶圆厂及封测厂产能能够满足公司需求。

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年3月24日、25日、26日